

1.

Information concernant le nom de l'entreprise, adresse de livraison, e-mail, téléphone, personne à contacter, données pour la facture.

2.

GERBER fichier (une copie de réserve, si c'est sur disquette)

3.

Information sur chaque type de circuit imprimé:

- nom de fichier, avec des modèles préfabriqués – oui/non

- nombre de circuits imprimés/ ébauches

- nombre de couches - (CISF) - simple face

(CIDF) - double face

(CIMC) - multicouche, jusqu'à 8 couches

- Vernis épargne - (cm) - la même des deux côtés,

(cm²) - différente des deux côtés

- Impression blanche/ de service/

- (IB) - d'un côté

- (IB²) - des deux côtés

- Matériel de base - standard FR-4, 35µm, 1,5mm, (de même 0,65mm, 0,8mm, 1mm, 2mm, 18µm, 70µm, 105µm)

- conditions supplémentaires – /fraisage de panneaux,, en contour, Ritzen, HAL, dorure galvanique de couplages, couche carbonique, test électronique/. HAL est une technologie dont les surfaces couvertes de vernis épargne restent en cuivre.

- ouvertures avant/ après métallization – cela concerne les circuits imprimés à double face et multicouches – après la métallisation la dimensions des ouvertures se diminue de 0,1 mm. Par défaut, la dimension est avant métallization. Il est possible l'unification des perceuses au cours du travail.

- délai – normalement 3 semaines, 10, 7, 5 et 3 jours de travail.

-
1.

min. ouverture – **0,35mm (0,014inch)**, max. ouverture -

6,3mm (0,248inch)

-
1.

min. difference panneau - ouverture – **0,4mm (0,016inch)**

3. min. largeur de piste – **0,2mm (0,008inch)**

1.

min. distance panneau-piste et piste-piste –

0,2mm (0,008inch)

1.

Au cas de fichiers **GERBER** préparés, il est nécessaire d'envoyer la liste des ouvertures /pour le format **GERBER-274X** il se trouve dans le fichier lui-meme/, ainsi que le fichier pour perçage dans le format

EXCELLON
drill file

,
2.4
,

leading
zeroes

.

2.

Il est souhaitable de poser des inscriptions **top** et **bottom** pour orientation.

3.

Elaboration de stencil et assemblage SMD **automatique**.